

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零一七年第二季度業績公佈

*所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。*

*本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。*

中國香港 — 2017年8月8日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一七年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

### 二零一七年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入創歷史新高至 1.981 億美元，環比增長 8.1%，同比增長 11.5%。
- 毛利率 33.2%，環比上升 3.5 個百分點，同比上升 2.4 個百分點。
- 期內溢利 3,440 萬美元，環比上升 0.8%，同比下降 11.9%。
- 每股盈利 0.03 美元，環比持平，同比下降 0.01 美元。
- 淨資產收益率 2.2%。

### 二零一七年第三季度指引

- 我們預計銷售收入環比增長約 5%。
- 我們預計毛利率在 33% 左右。

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對第二季度的業績評論道：

得益于強勁的市場需求和零缺陷的生產運營，公司本季度又一次取得了成功。本季度銷售收入創歷史新高，至 1.981 億美元，環比增長 8.1%，同比增長 11.5%。毛利率上升至 33.2%，環比增加 3.5 個百分點，這主要歸功於產品組合的優化以及產能利用率的提升。淨利潤率達 17.3%。銷售收入和毛利率都再次超過上季度指引。

“對於未來，我們持持續積極的展望，這主要基於三個主要因素，”王煜先生繼續說道，“首先，我們相信我們的工廠會在下半年繼續保持最佳營運狀態。其次，本年度客戶對於嵌入式非易失性存儲器和分立器件產品的需求十分旺盛，而這正是我們最擅長的領域，包括銀行卡、身份證卡、超級結和 IGBT 等產品。最後，從技術角度看，我們的多家客戶已將其嵌入式閃存產品遷移至 90 納米工藝技術節點，這將在未來很長時間內成爲智能卡和 MCU 產品收入的主要來源。基於以上這些原因，我們正全力以赴，確保擴產計劃如期完成，使我們的股東能從這一強勁升勢中獲利。”

## 電話會議公告

日期：二零一七年八月九日

時間：下午 04:00（上海 / 香港）  
上午 04:00（紐約，2017 年 8 月 9 日）

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

[http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 或

[https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2017\\_q2\\_earnings\\_call](https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2017_q2_earnings_call)

電話詳細：	國際	+65 6713 5521
	中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
	香港	+852 3018 6768
	臺灣	+886 277 031 751
	紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名：61417682

密碼：HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 [http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 網頁上，重複收聽會議。

## 關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

**經營業績概要**  
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	198,068	183,236	177,692	8.1 %	11.5 %
銷售成本	(132,401)	(128,801)	(122,988)	2.8 %	7.7 %
<b>毛利</b>	<b>65,667</b>	<b>54,435</b>	<b>54,704</b>	<b>20.6 %</b>	<b>20.0 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>33.2 %</b>	<b>29.7 %</b>	<b>30.8 %</b>	<b>3.5</b>	<b>2.4</b>
經營開支	(27,371)	(22,425)	(25,585)	22.1 %	7.0 %
其他收入淨額	2,174	2,403	16,171	(9.5)%	(86.6)%
<b>稅前溢利</b>	<b>40,470</b>	<b>34,413</b>	<b>45,290</b>	<b>17.6 %</b>	<b>(10.6)%</b>
所得稅開支	(6,117)	(347)	(6,285)	1,662.8 %	(2.7)%
<b>期內溢利</b>	<b>34,353</b>	<b>34,066</b>	<b>39,005</b>	<b>0.8 %</b>	<b>(11.9)%</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>17.3 %</b>	<b>18.6 %</b>	<b>22.0 %</b>	<b>(1.3)</b>	<b>(4.7)</b>
每股盈利					
基本	0.03	0.03	0.04	-	(25.0)%
攤薄	0.03	0.03	0.04	-	(25.0)%
付運晶圓(仟片)	459	432	441	6.3 %	4.1 %
<b>產能利用率<sup>1</sup></b>	<b>99.4 %</b>	<b>96.2 %</b>	<b>95.5 %</b>	<b>3.2</b>	<b>3.9</b>
<b>淨資產收益率<sup>2</sup></b>	<b>2.2 %</b>	<b>2.3 %</b>	<b>2.6 %</b>	<b>(0.1)</b>	<b>(0.4)</b>

- 銷售收入 1.981 億美元，創歷史新高，環比增長 8.1%，同比增長 11.5%。
- 銷售成本 1.324 億美元，環比上升 2.8%，主要由於晶圓銷售量上升所致。
- 毛利率 33.2%，環比上升 3.5 個百分點，主要由於產品組合的優化和產能利用率的提升。
- 經營開支 2,740 萬美元，環比上升 22.1%，主要由於(i)研發開支上升，及(ii)計提半年度獎金。
- 其他收入淨額 220 萬美元，環比下降 9.5%，主要由於匯兌損失的增加，部分被分佔一家聯營公司溢利所抵消，上季度發生分佔一家聯營公司損失。
- 所得稅開支 610 萬美元，環比上升 1,662.8%，主要由於上季度轉回股利代扣代繳稅金。
- 期內溢利 3,440 萬美元，環比上升 0.8%。
- 淨利潤率 17.3%，環比下降 1.3 個百分比。
- 每股盈利 0.03 美元。
- 淨資產收益率 2.2%。

<sup>1</sup> 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup> 期內溢利/加權平均淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	194,502	98.2 %	179,109	97.7 %	15,393	8.6 %
其他	3,566	1.8 %	4,127	2.3 %	(561)	(13.6)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>183,236</b>	<b>100.0 %</b>	<b>14,832</b>	<b>8.1 %</b>

- 本季度 98.2% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 <sup>3</sup>	111,180	56.2 %	96,579	52.8 %	14,601	15.1 %
美國	31,351	15.8 %	30,985	16.9 %	366	1.2 %
亞洲 <sup>4</sup>	21,218	10.7 %	26,108	14.2 %	(4,890)	(18.7)%
歐洲	19,376	9.8 %	15,262	8.3 %	4,114	27.0 %
日本 <sup>5</sup>	14,943	7.5 %	14,302	7.8 %	641	4.5 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>183,236</b>	<b>100.0 %</b>	<b>14,832</b>	<b>8.1 %</b>

- 本季度來自中國的銷售收入 1.112 億美元，占銷售收入總額的 56.2%，環比增長 15.1%，主要得益於智能卡芯片、MCU 和 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,140 萬美元，環比增長 1.2%，主要由於 MCU 產品的需求增加，部分被模擬產品的需求減少所抵消。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 2,120 萬美元，環比減少 18.7%，主要由於 MCU 和邏輯產品的需求減少。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,940 萬美元，環比增長 27.0%，主要得益於智能卡芯片和通用 MOSFET 產品的需求增加。

<sup>3</sup>包括香港。

<sup>4</sup>不包括中國及日本。

<sup>5</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	81,033	41.0 %	69,235	37.8 %	11,798	17.0 %
分立器件	52,391	26.5 %	48,341	26.4 %	4,050	8.4 %
模擬與電源管理	35,935	18.1 %	34,523	18.8 %	1,412	4.1 %
邏輯及射頻	22,187	11.2 %	26,047	14.2 %	(3,860)	(14.8)%
獨立非易失性存儲器	6,041	3.0 %	4,547	2.5 %	1,494	32.9%
其他	481	0.2 %	543	0.3 %	(62)	(11.4)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>183,236</b>	<b>100.0 %</b>	<b>14,832</b>	<b>8.1 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,100 萬美元，環比增長 17.0%，主要由於智能卡芯片和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 5,240 萬美元，環比增長 8.4%，主要由於 IGBT，通用 MOSFET 和超級結產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,590 萬美元，環比增長 4.1%，主要由於 LED 照明產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,220 萬美元，環比減少 14.8%，主要由於射頻產品的需求減少。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 600 萬美元，環比增長 32.9%，主要由於閃存產品的需求增加。

### 銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	63,734	32.2 %	61,303	33.5 %	2,431	4.0 %
0.15μm 及 0.18μm	34,502	17.4 %	32,075	17.5 %	2,427	7.6 %
0.25μm	5,194	2.6 %	3,095	1.7 %	2,099	67.8 %
0.35μm 及以上	94,638	47.8 %	86,763	47.3 %	7,875	9.1 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>183,236</b>	<b>100.0 %</b>	<b>14,832</b>	<b>8.1 %</b>

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 6,370 萬美元，環比增長 4.0%，主要由於智能卡芯片和 MCU 產品的需求增加，部分被射頻產品需求減少所抵消。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,450 萬美元，環比增長 7.6%，主要由於智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 520 萬美元，環比增長 67.8%，主要由於邏輯和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 9,460 萬美元，環比增長 9.1%，主要由於智能卡芯片、IGBT、通用 MOSFET 和 LED 照明產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一七年	二零一七年	二零一七年	二零一七年	環比	環比
	第二季度	第二季度	第一季度	第一季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
電子消費品	133,870	67.6%	128,654	70.3%	5,216	4.1 %
通訊	28,994	14.6%	23,145	12.6%	5,849	25.3 %
工業及汽車	26,145	13.2%	22,025	12.0%	4,120	18.7 %
計算機	9,059	4.6%	9,412	5.1%	(353)	(3.8)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0%</b>	<b>183,236</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,832</b>	<b>8.1 %</b>

- 電子消費品及通訊仍是我們的第一及第二大終端市場分佈，本季度合計貢獻 82.2%的銷售收入，上季度為 82.9%。
- 本季度電子消費品銷售收入 1.339 億美元，環比增長 4.1%，主要由於智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,900 萬美元，環比增長 25.3%，主要由於智能卡芯片、邏輯和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 2,610 萬美元，環比增長 18.7%，主要由於 MCU、IGBT、通用 MOSFET 產品和智能卡芯片的需求增加。

產能<sup>6</sup>及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一七年	二零一七年	二零一六年
	第二季度	第一季度	第二季度
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
1 號晶圓廠	60	56	56
2 號晶圓廠	57	57	55
3 號晶圓廠	42	42	40
<b>合計</b>	<b>159</b>	<b>155</b>	<b>151</b>
<b>產能利用率</b>	<b>99.4%</b>	<b>96.2%</b>	<b>95.5%</b>

- 產能利用率由上季度的 96.2 % 上升至本季度的 99.4%，主要由於上季度進行年度維護所致。

<sup>6</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

仟片晶圓	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	459	432	441	6.3 %	4.1 %

- 本季度付運晶圓 459 仟片，環比增加 6.3%，主要由於客戶需求增加。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	1,753	1,500	1,721	16.9 %	1.9 %
管理費用 <sup>7</sup>	25,618	20,925	23,864	22.4 %	7.3 %
<b>經營開支</b>	<b>27,371</b>	<b>22,425</b>	<b>25,585</b>	<b>22.1 %</b>	<b>7.0 %</b>

- 經營開支 2,740 萬美元，環比上升 22.1%，主要由於(i)研發開支上升，及(ii)計提半年度獎金。

### 其他收入淨額分析

以千美元計	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,299	3,049	3,075	8.2 %	7.3 %
利息收入	1,533	1,445	1,203	6.1 %	27.4 %
匯兌(損失)/收益	(2,689)	(1,353)	3,006	98.7 %	(189.5)%
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	157	(298)	3,455	(152.7)%	(95.5)%
財務費用	(534)	(515)	(999)	3.7 %	(46.5)%
政府補貼	210	384	6,115	(45.3)%	(96.6)%
其他	198	(309)	316	(164.1)%	(37.3)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>2,174</b>	<b>2,403</b>	<b>16,171</b>	<b>(9.5)%</b>	<b>(86.6)%</b>

- 其他收入淨額 220 萬美元，環比下降 9.5%，主要由於匯兌損失的增加，部分被分佔一家聯營公司溢利所抵消，上季度發生分佔一家聯營公司損失。

<sup>7</sup>管理費用包括確認為研發開支抵銷項目的政府補助。

### 現金流量分析

以千美元計	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	64,575	30,049	45,840	114.9 %	40.9 %
投資活動所用現金流量淨額	(114,525)	(44,456)	(83,684)	157.6 %	36.9 %
融資活動所用現金流量淨額	(40,236)	(512)	(36,939)	7,758.6 %	8.9 %
外匯匯率變動影響淨額	3,835	1,452	(13,187)	164.1 %	(129.1)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>(86,351)</b>	<b>(13,467)</b>	<b>(87,970)</b>	<b>541.2 %</b>	<b>(1.8)%</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 6,460 萬美元，環比上升 114.9%，主要由於(i) 貿易應收款項及應收票據的回收增加，(ii) 上季度支付年終獎金，及(iii) 收到一家關聯公司支付租金款，部分被支付 2016 年度所得稅所抵消。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 1.145 億美元，其中包括(i) 定期存款投資支出 7,250 萬美元，(ii) 設備投資支出 4,330 萬美元，部分被利息收入 130 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所用現金流量淨額 4,020 萬美元，包括(i) 支付股息 3,970 萬美元，和(ii) 銀行貸款利息支出 50 萬美元。

### 資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)
資產總額	1,900,935	1,867,537
負債總額	345,672	335,805
所有者權益總額	1,555,263	1,531,732
資產負債率 <sup>8</sup>	18.2%	18.0%

### 資本開支

以千美元計	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第一季度 (未經審核)
資本開支	43,329	40,942

- 本季度資本開支 4,330 萬美元，上季度為 4,090 萬美元。

<sup>8</sup> 資產負債率=負債總額/資產總額。

## 流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)
存貨	100,875	96,038
貿易應收款項及應收票據	107,565	109,026
預付款項、按金及其他應收款項	11,836	13,960
應收關聯方款項	53,013	53,625
已凍結存款及定期存款	202,834	130,341
現金及現金等價物	241,437	327,788
<b>流動資產總額</b>	<b>717,560</b>	<b>730,778</b>
貿易應付款項	60,999	62,172
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	116,474	98,913
計息銀行借款	4,133	1,884
政府補助	38,880	38,176
應付關聯方款項	16,223	9,455
應付所得稅	16,259	30,269
<b>流動負債總額</b>	<b>252,968</b>	<b>240,869</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>464,592</b>	<b>489,909</b>
速動比率	2.4x	2.6x
流動比率	2.8x	3.0x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	55	59
存貨周轉天數	67	67

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,400 萬美元下降至本季度末的 1,180 萬美元，主要由於對供應商的預付款減少。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 1.303 億美元上升至本季度末的 2.028 億美元，主要由於定期存款增加 7,250 萬美元。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 9,890 萬美元上升至本季度末的 1.165 億美元，主要由於(i)資本支出應付款增加，(ii)計提半年度獎金，及(iii)預收客戶款項增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 190 萬美元上升至本季度末的 410 萬美元，由於一年內到期的長期借款增加。
- 應付關聯方款項由上季度末的 950 萬美元上升至本季度末的 1,620 萬美元，主要由於收到一家關聯方的預付租金款。
- 應付所得稅由上季度末的 3,030 萬美元下降至本季度末的 1,630 萬美元，主要由於支付 2016 年度所得稅。
- 本季度末淨營運資金 4.646 億美元，流動比率 2.8。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 55 天。
- 本季度存貨周轉天數為 67 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一六年 (未經審核)
銷售收入	198,068	183,236	177,692
銷售成本	(132,401)	(128,801)	(122,988)
<b>毛利</b>	<b>65,667</b>	<b>54,435</b>	<b>54,704</b>
其他收入及收益	5,240	5,081	13,751
銷售及分銷費用	(1,753)	(1,500)	(1,721)
管理費用	(25,618)	(20,925)	(23,864)
其他費用	(2,689)	(1,865)	(36)
財務費用	(534)	(515)	(999)
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	157	(298)	3,455
<b>稅前溢利</b>	<b>40,470</b>	<b>34,413</b>	<b>45,290</b>
所得稅開支	(6,117)	(347)	(6,285)
<b>期內溢利</b>	<b>34,353</b>	<b>34,066</b>	<b>39,005</b>
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	34,353	34,066	39,005
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.03	0.03	0.04
攤薄	0.03	0.03	0.04
<b>用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,033,871,656</b>	<b>1,033,871,656</b>	<b>1,033,871,656</b>
<b>用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,043,950,656</b>	<b>1,041,332,656</b>	<b>1,035,737,656</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一六年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	714,933	678,861	678,183
投資物業	173,132	169,997	176,795
預付土地租賃款項	20,228	20,021	21,329
無形資產	8,282	8,226	6,987
於聯營公司的投資	46,059	45,070	42,984
可供出售投資	208,210	204,441	212,707
長期預付款項	5,434	4,065	6,519
遞延稅項資產	7,097	6,078	5,768
<b>非流動資產總額</b>	<b>1,183,375</b>	<b>1,136,759</b>	<b>1,151,272</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	100,875	96,038	101,270
貿易應收款項及應收票據	107,565	109,026	103,521
預付款項、按金及其他應收款項	11,836	13,960	11,810
應收關聯方款項	53,013	53,625	40,429
已凍結存款及定期存款	202,834	130,341	61,195
現金及現金等價物	241,437	327,788	457,909
<b>流動資產總額</b>	<b>717,560</b>	<b>730,778</b>	<b>776,134</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	60,999	62,172	58,442
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	116,474	98,913	120,446
計息銀行借款	4,133	1,884	42,750
政府補助	38,880	38,176	51,753
應付關聯方款項	16,223	9,455	10,091
應付所得稅	16,259	30,269	14,645
<b>流動負債總額</b>	<b>252,968</b>	<b>240,869</b>	<b>298,127</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>464,592</b>	<b>489,909</b>	<b>478,007</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>1,647,967</b>	<b>1,626,668</b>	<b>1,629,279</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	89,373	90,946	137,063
遞延稅項負債	3,331	3,990	6,069
<b>非流動負債總額</b>	<b>92,704</b>	<b>94,936</b>	<b>143,132</b>
<b>淨資產</b>	<b>1,555,263</b>	<b>1,531,732</b>	<b>1,486,147</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,550,164	1,550,164	1,550,164
儲備	5,099	(18,432)	(64,017)
<b>權益總額</b>	<b>1,555,263</b>	<b>1,531,732</b>	<b>1,486,147</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一六年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量：</b>			
稅前溢利	40,470	34,413	45,290
折舊及攤銷	25,153	23,541	20,483
應佔聯營公司(溢利)/虧損	(157)	298	(3,455)
營運資金的變動及其它	(891)	(28,203)	(16,478)
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>64,575</b>	<b>30,049</b>	<b>45,840</b>
<b>投資活動所用現金流量：</b>			
購買物業、廠房及設備項目	(43,329)	(40,942)	(51,433)
其他投資活動所用的現金流量	(71,196)	(3,514)	(32,251)
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(114,525)</b>	<b>(44,456)</b>	<b>(83,684)</b>
<b>融資活動所用現金流量：</b>			
向股東支付股息	(39,673)	-	(15,401)
已凍結存款的增加	(25)	-	(20,529)
已付利息	(538)	(512)	(1,009)
<b>融資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(40,236)</b>	<b>(512)</b>	<b>(36,939)</b>
現金及現金等價物減少淨額	(90,186)	(14,919)	(74,783)
外匯匯率變動影響淨額	3,835	1,452	(13,187)
期初現金及現金等價物	327,788	341,255	545,879
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>241,437</b>	<b>327,788</b>	<b>457,909</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

王煜(總裁)

**非執行董事**

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一七年八月八日